

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。該等債券不可於香港或其他地方進行一般認購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述股份及該等債券並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。該等股份及債券不會於美國公開發售。



Semiconductor Manufacturing International Corporation
中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：981)

**完成發行本金額200百萬美元二零二二年到期零息可換股債券，
並與現有450百萬美元二零二二年到期零息可換股債券
合併並形成單一系列**

獨家全球協調人



獨家賬簿管理人及經辦人



茲提述本公司日期為二零一九年十一月十九日有關(其中包括)建議發行獲配售債券的公告(「該公告」)。除非文義另有規定,否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公布,根據獲配售債券認購協議發行獲配售債券的所有先決條件經已達成,本金額200百萬美元獲配售債券的發行經已於二零一九年十二月九日完成。本公司已取得聯交所有關批准167,950,270股獲配售換股股份上市及買賣的有條件批准及亦接獲新交所有關獲配售債券上市及報價的批准。獲配售債券於二零一九年十二月十日於新交所上市。發行獲配售債券的估計所得款項淨額(扣除費用、佣金及開支)約為229.5百萬美元。

經辦人已知會本公司,獲配售債券已獲提呈發售及出售予六名或以上獨立承配人(彼為獨立個人、公司及/或機構投資者)。據本公司作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信,各承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)為與本公司或其任何附屬公司或彼等各自的董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自任何的聯繫人概無關連的獨立第三方。

按照獲配售債券認購協議日期的有效換股價每股股份10.73港元並假設按該有效換股價全數兌換獲配售債券,獲配售債券將可兌換為約167,950,270股獲配售換股股份,相當於(i)本公司於最後交易日已發行股本約3.32%以及(ii)假設按獲配售債券認購協議日期的有效換股價全數兌換獲配售債券後本公司經擴大已發行股本約3.22%(假設除發行獲配售換股股份外,本公司已發行股本概無變更)。

根據分別向大唐及國家集成電路基金授予優先權的大唐購買協議及國家集成電路基金購買協議,大唐及國家集成電路基金已各自選擇或被視作已選擇(視情況而定)不行使有關發行獲配售債券以及大唐優先認購事項或國家集成電路基金優先認購事項的優先權(視情況而定)。

下表顯示(i)本公司現有股權架構；(ii)緊隨發行獲配售債券後的股權架構，假設並無獲配售債券獲兌換為獲配售換股股份；及(iii)緊隨發行獲配售債券後及獲配售債券獲得全數兌換後的股權架構。

股東	現有(於二零一九年十二月九日)		緊隨獲配售債券後			
	估本公司		假設並無兌換獲配售債券		假設按獲配售債券認購協議	
	股份數目	已發行股本%	股份數目	已發行股本%	日期的有效換股價全數兌換	獲配售債券(附註2)
						估本公司
大唐(附註3)	859,522,595	17.00%	859,522,595	17.00%	859,522,595	16.46%
國家集成電路基金(附註4)	797,054,901	15.77%	797,054,901	15.77%	797,054,901	15.26%
獲配售債券持有人	0	0.00%	0	0.00%	167,950,270	3.21%
其他股東	<u>3,398,687,159</u>	<u>67.23%</u>	<u>3,398,687,159</u>	<u>67.23%</u>	<u>3,398,687,159</u>	<u>65.07%</u>
總計	<u>5,055,264,655</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,055,264,655</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,223,214,925</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 假設除獲配售債券外，本公司概無發行或購回股份、概無該等優先債券獲發行、概無行使購股權、概無授出受限制股份單位、且概無兌換任何證券為股份。於二零一九年十月三十一日，本公司有21,223,764份未行使購股權。
2. 假設除獲配售債券外，本公司概無發行或購回股份、概無該等優先債券獲發行、概無行使購股權、概無授出受限制股份單位、且概無兌換任何獲配售債券以外的證券為股份。於二零一九年十月三十一日，本公司有21,223,764份未行使購股權。
3. 所有該等股份由大唐的全資附屬公司大唐香港持有。
4. 所有該等股份由國家集成電路基金的全資附屬公司鑫芯香港持有。

授出豁免

上市規則第13.36(6)條規定，除非初始轉換價格不低於股份於配售時的基準價(定義見上市規則第13.36(5)條)，否則發行人不得根據上市規則第13.36(2)(b)條賦予的一般性授權以現金代價發行可轉換為發行人新股份的證券。

如該公告所披露，根據獲配售債券的條款及條件，於兌換獲配售債券時將予發行的換股股份的價格初步為每股股份0.925港元。鑒於本公司進行股份合併(其詳情於本公司日期為二零一六年十二月六日的公告披露)，有關換股價調節為每股股份9.25港元。每股股份的現有換股價9.25港元初步低於配售時股份的基準價(定義見上市規則第13.36(5)條)。

如該公告所披露，於該公告日期的有效換股價為每股股份10.73港元，不低於配售時股份的基準價(定義見上市規則第13.36(5)條)。

於考慮(其中包括)以下具體情況後，本公司已向聯交所申請及聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第13.36(6)條的規定：

- a) 其為增加發行，而於增加發行中發行的獲配售債券將與現有債券合併並形成單一系列。因此，除發行價外，所有條款及條件均為固定，並需與規管現有債券的條款及條件相同。故此，編製及簽立獲配售債券的時間成本以及經濟成本可能減輕；
- b) 現有債券於新交所上市，而由於現有債券的交易價格較高，因此增加發行中的獲配售債券將以高於面值的溢價發行。故此，根據獲配售債券兌換的股份亦可視為以高於初始兌換價的溢價發行；及
- c) 現有債券及獲配售債券均為二零二二年到期的零息可換股債券，符合本公司新資金融資的目標，而增加發行將擴大現有債券的本金額，為債券持有人於當前市場帶來了額外的流動性。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海
二零一九年十二月十日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

* 僅供識別